

【原因・判断ポイント・発生工程】多層板積層工程で、銅箔上に介在したプリプレグ屑がそのまま積層され、銅めっきされた為、プリプレグ屑がE Tレジストとなり出来たもの（多層板積層～E T工程）

【原因、判断要点、发生工序】在多层板的层压工序，铜箔上夹杂的B片屑未经处理就层压、然后又镀铜，B片屑成为ET剂所引起的（多层板层压～ET工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】A prepreg debris staying on a copper foil is laminated together in multilayer lamination and remained after plating. The prepreg debris acts as an etching resist causing the defect. (Multilayer lamination - etching process)



【コメント】
プリプレグの下に積層板の銅箔がのこっている
顕微鏡倍率×

【注釋】
在层压板的铜箔下面存在B片屑
显微镜倍率×

【Comments】
Left photo is a Copper foil of laminate remaining under prepreg debris
Magnification: ×

1-6-1-3 積層銅箔面糊付着残銅／銅箔表面胶迹的残余铜 / Residual copper under paste adhered on laminated copper foil

【特徴】導体間隔部や非導体部に粘着物付着形状態に残っている残銅

【特征】在导线间隔区或非导线区附着粘性物而引起的残余铜。

【Characteristics】Residual copper in a conductor gap or on non-conductive area in the shape of adhesive.

【原因・判断ポイント・発生工程】積層板銅箔表面又はめっき銅表面に付着した粘着物がE Tレジストとなった為に出来たもの（めっき前～E T工程）

【原因、判断要点、发生工序】在层压板铜箔表面，或者镀铜层表面附着的粘性物成为ET剂而引起的（电镀前～ET工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】Adhesive attached to the surface of CCL copper or plated copper acts an etching resist to cause the defect. (Preparation of plating - etching process)



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率×

【Comments】
Magnification: ×